

5240

HD D-SUB Steckverbinder - SMT - 90° Notebook Version

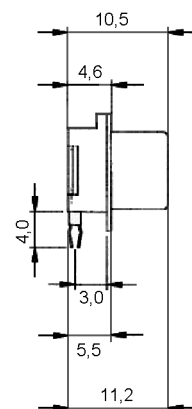
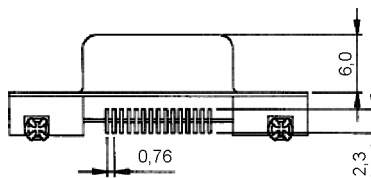
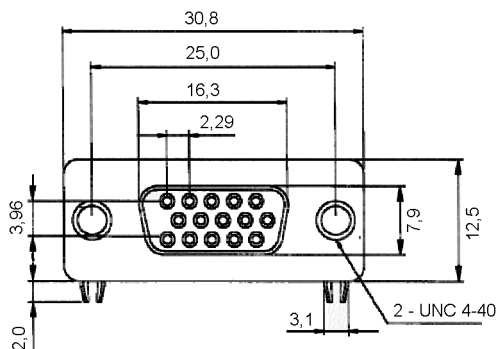
High Density D-SUB Connector - SMT - Right-Angled Notebook Type

Technische Daten / Technical Data:

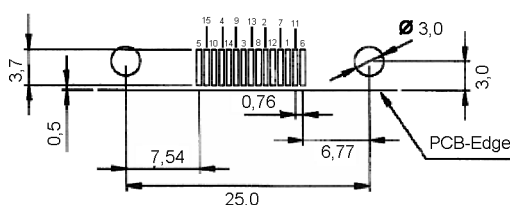
Gehäuse	Stahl vernickelt, verzinkt
Shell	steel, tin coated over nickel
Isolierkörper	Thermoplastischer Polyester, nach UL94V0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94V0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	copper alloy
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Contact Surface	gold plated over nickel
Lötbarkeit	IEC512-12A
Solderability	IEC512-12A
Durchgangswiderstand	≤ 10 mOhm
Contact Resistance	≤ 10 mOhm
Isolationswiderstand	> 10 ⁹ Ohm
Insulation Resistance	> 10 ⁹ Ohm
Spannungsfestigkeit	1000 V _{AC}
Test Voltage	1000 V _{AC}
Nennstrom	3 A
Current Rating	3 A
Temperaturbereich	-55°C...+125°C
Temperature Range	-55°C...+125°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T
Processing	Reflow-Soldering, further informations in chapter T



© W+P PRODUCTS



PCB-Layout



Series

5240

Contacts

15

15-pol.

Terminal

2

2 = Buchse
female

Quality*

3

GK 1 = min. 500 Zyklen
quality class 1
GK 2 = min. 200 Zyklen
quality class 2
GK 3 = min. 50 Zyklen
quality class 3

(* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.)

(* Order example - To be replaced by your specifications.)

TEL.: +49 5223 98507-0
FAX : +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL: sales@wpro.com
INTERNET: www.wpro.com

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow-Soldering Informations

Reflow-Lötverfahren Reflow-Soldering

Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflowverfahren verarbeitet werden (Maximalwerte):

Profil Eigenschaft	Bleifreies Lötten
Durchschnitts-Ramp-Up Rate ($T_{s_{max}}$ to T_p)	3 °C / Sek. Max.
Vorheizen - Temperatur Min ($T_{s_{min}}$) - Temperatur Max ($T_{s_{max}}$) - Zeit ($t_{s_{min}}$ auf $t_{s_{max}}$)	150°C 200°C 60-180 Sekunden
Verbleiben oberhalb: - Temperatur (T_L) - Zeit (t_L)	217°C 60-150 Sekunden
Peak/Klassifizierung Temperatur (T_p)	260°C +/- 5°C
Zeit innerhalb von 5°C um die Peak-Temperatur (t_p)	20-40 Sekunden
Ramp-Down Rate	6°C / Sekunde max.
Zeit von 25°C bis zur Peak-Temperatur	8 Minuten max.

© W+P PRODUCTS

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature-profile for leadfree reflow-soldering (maximum values):

Profile Feature	PB-Free assembly
Average Ramp-Up Rate ($T_{s_{max}}$ to T_p)	3 °C / second max.
Preheat - Temperature Min ($T_{s_{min}}$) - Temperature Max ($T_{s_{max}}$) - Time ($t_{s_{min}}$ to $t_{s_{max}}$)	150°C 200°C 60-180 seconds
Time maintained above: - Temperature (T_L) - Time (t_L)	217°C 60-150 seconds
Peak/Classification Temperature (T_p)	260°C +/- 5°C
Time within 5°C of actual Peak Temperature (t_p)	20-40 seconds
Ramp-Down Rate	6°C / second max.
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.

Empfohlenes Reflow-Lötprofil:

Recommended Reflow-Soldering profile:



T